

# 蛍光X線分析装置

背景・目的

蛍光X線分析装置により、非破壊で測定対象物の元素を分析することができます。現場設備の材質推定、付着異物の元素分析などに利用しています。

分析例

電気設備内の調査

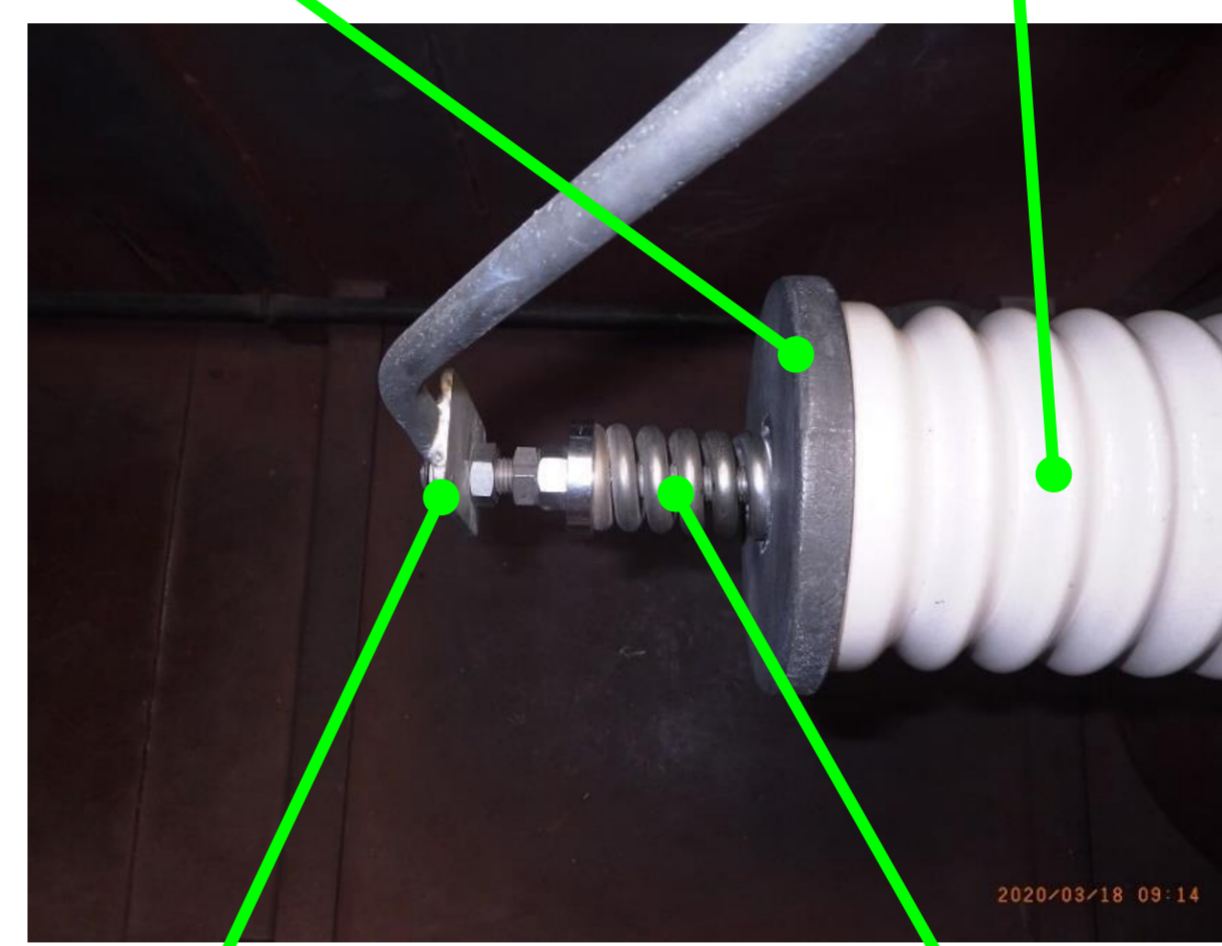


測定箇所



A ブス端板

③ 上金具 ① 碍子表面



⑩ 座金

⑨ スプリング



B 塗装板

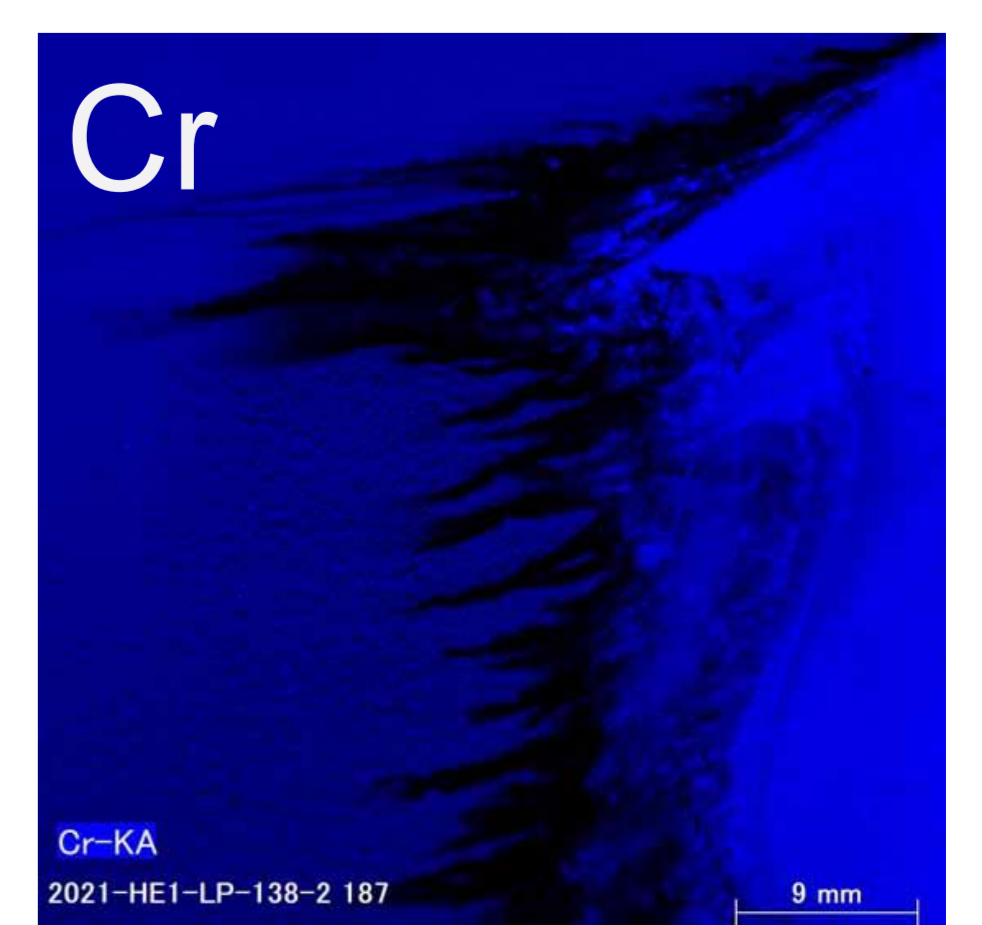
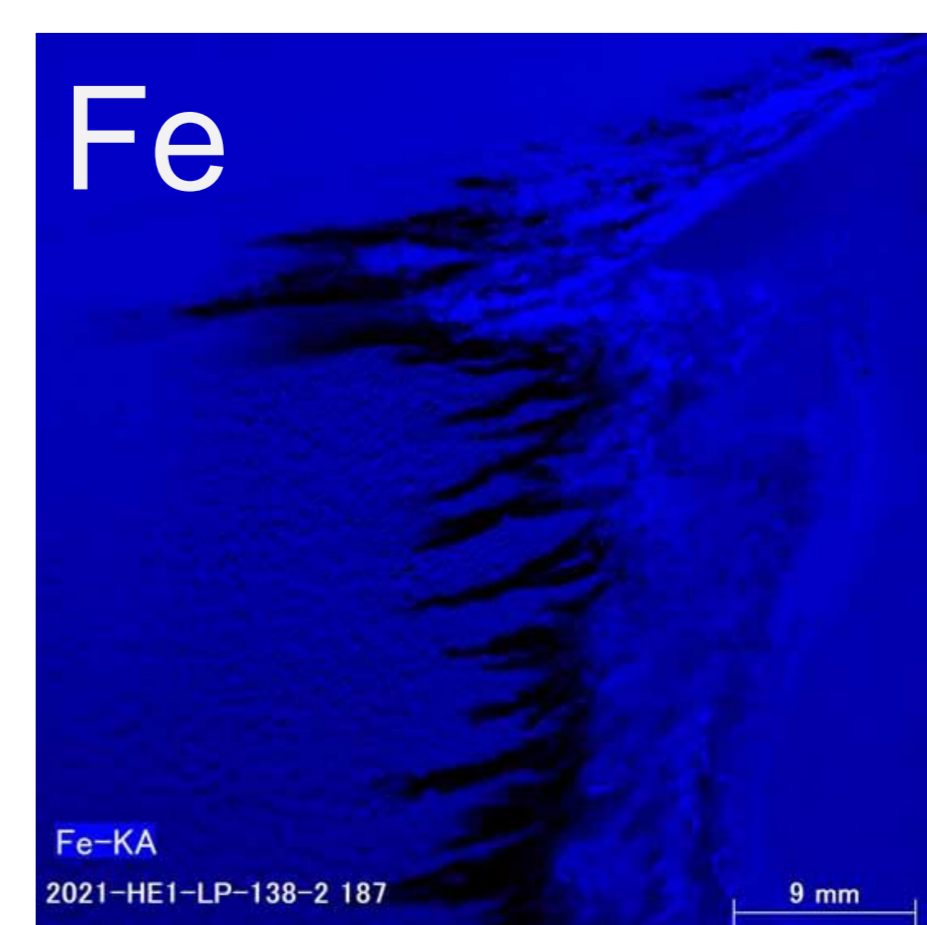
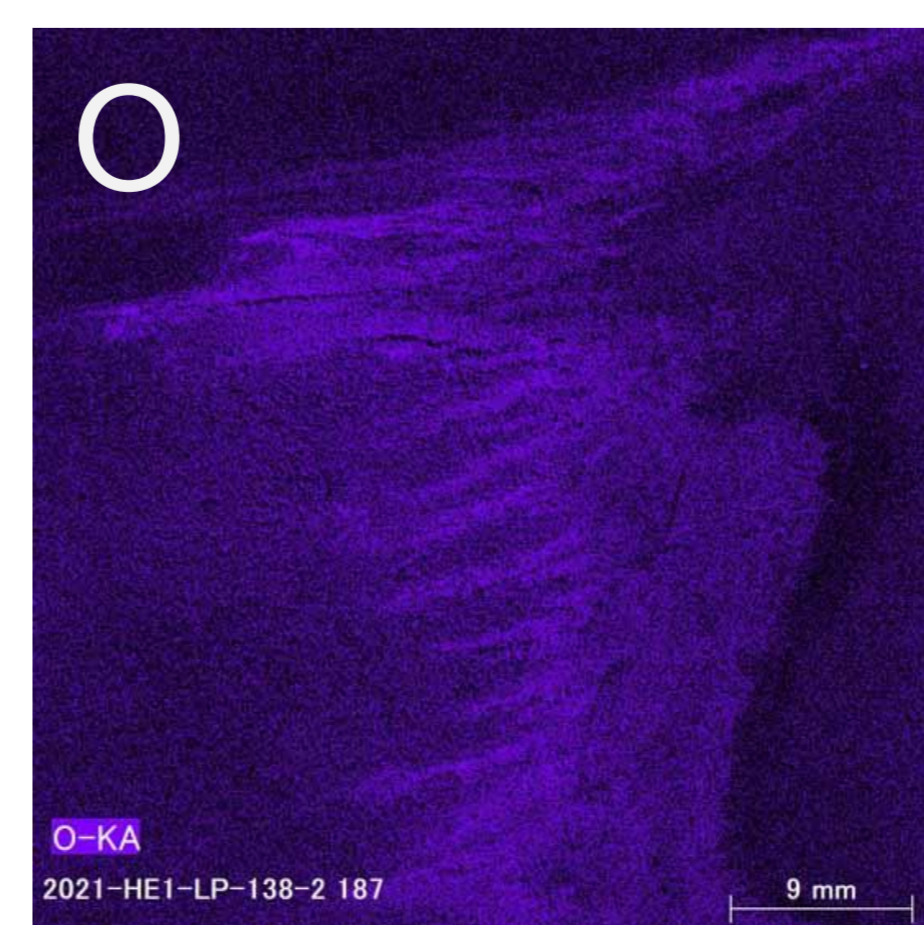
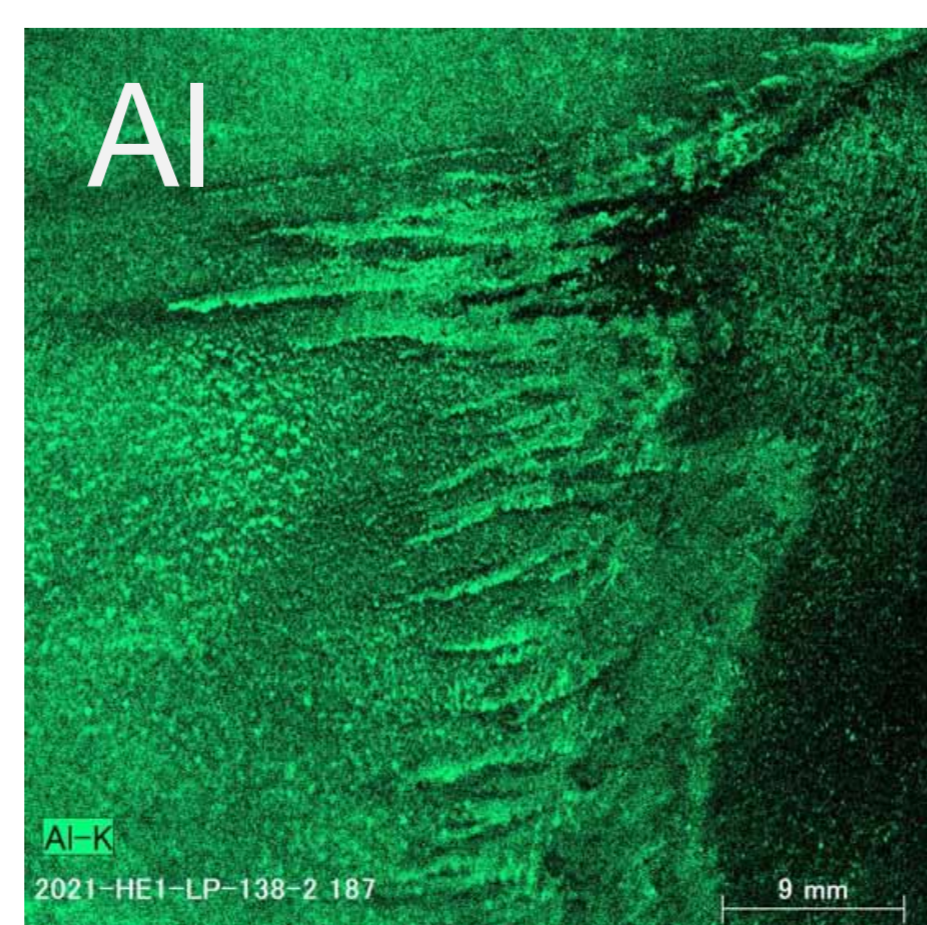
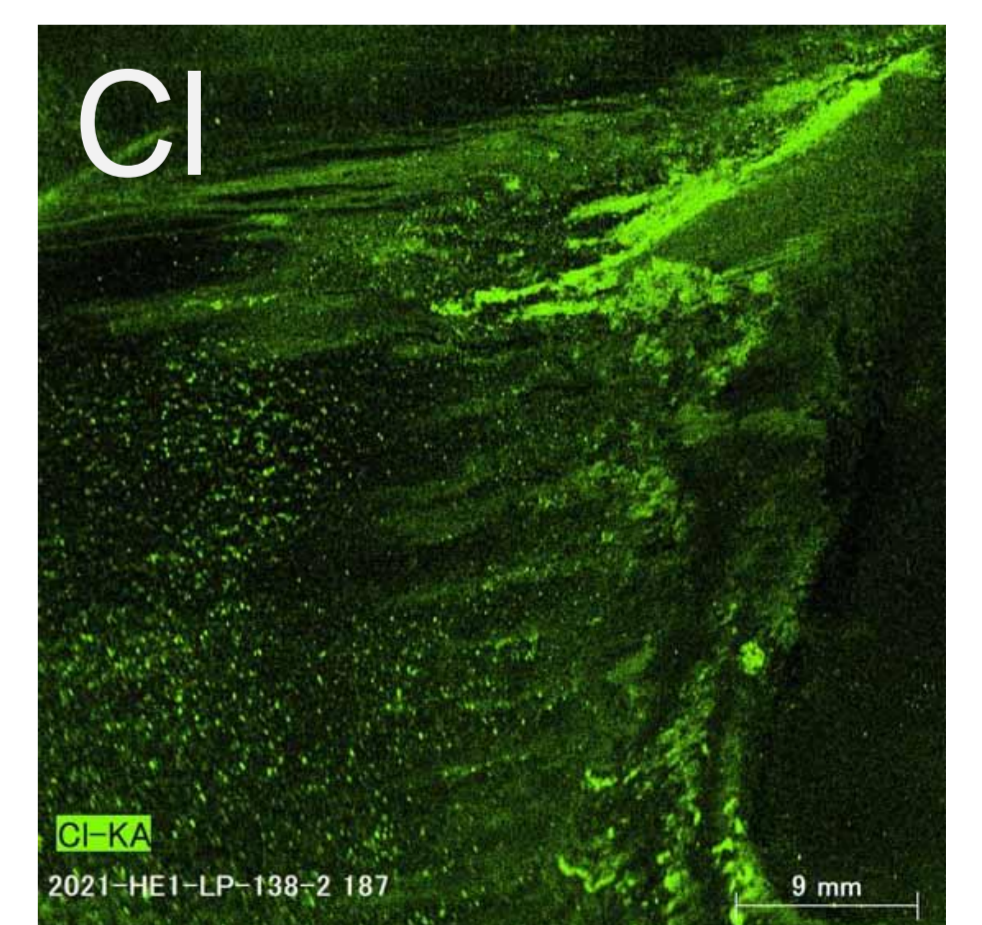
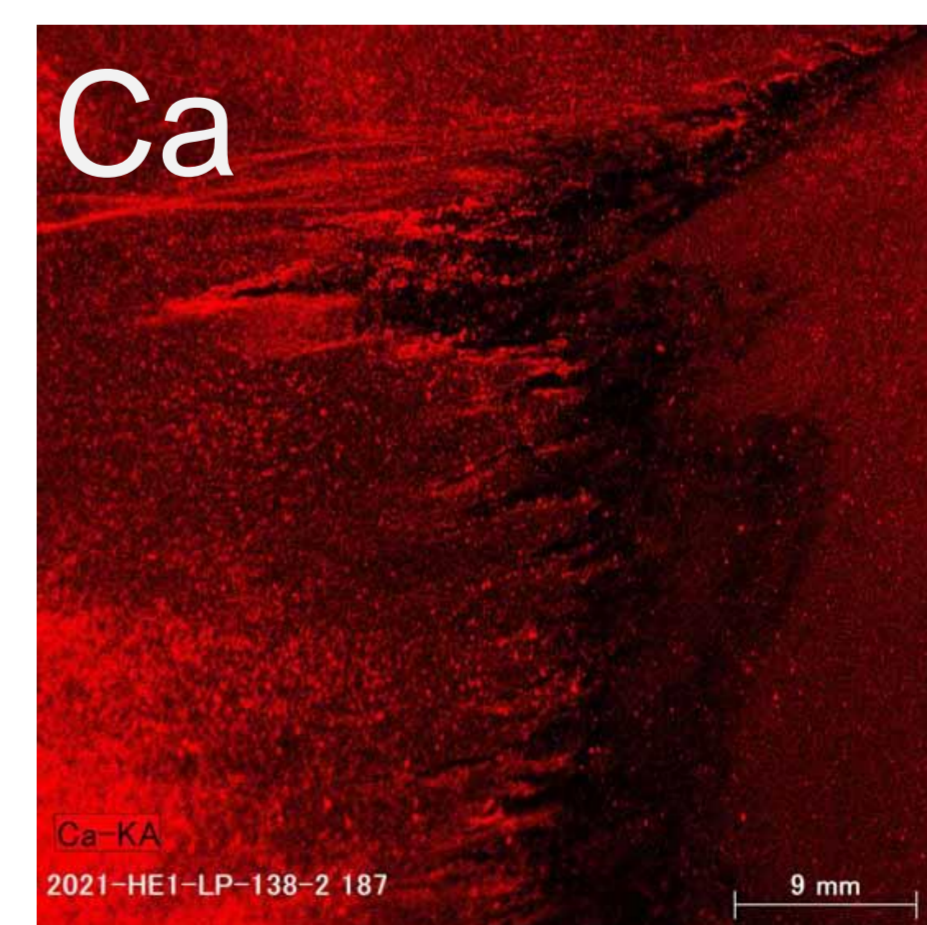
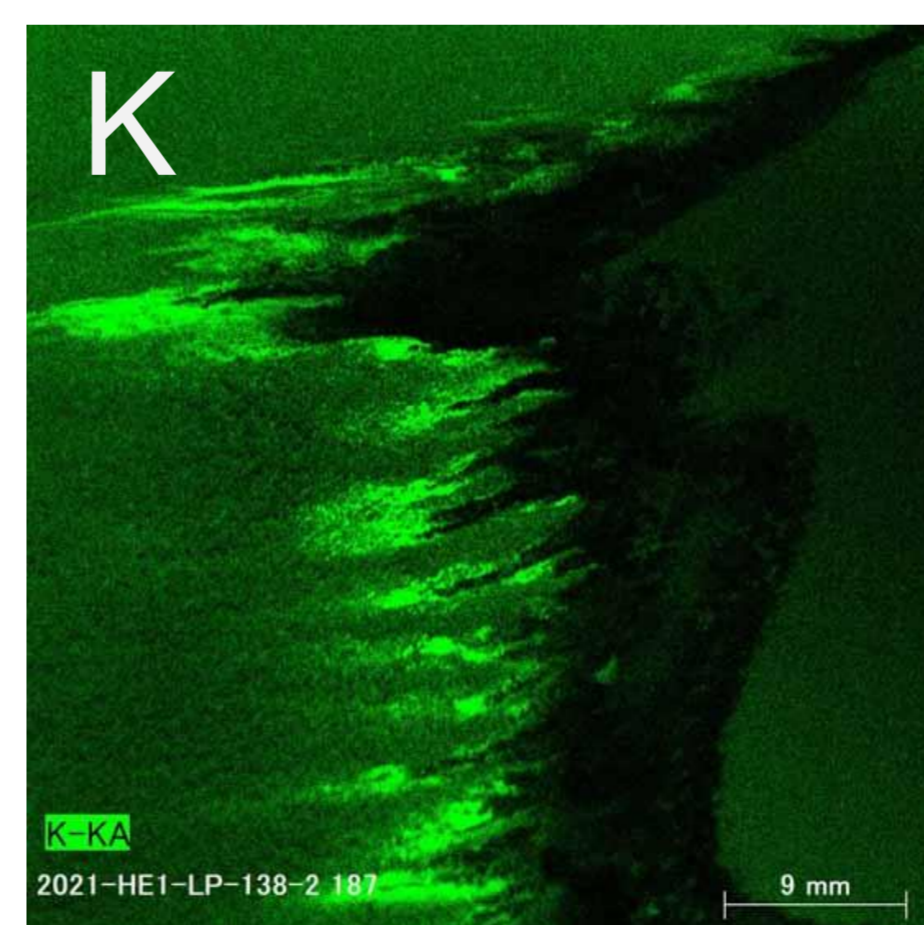
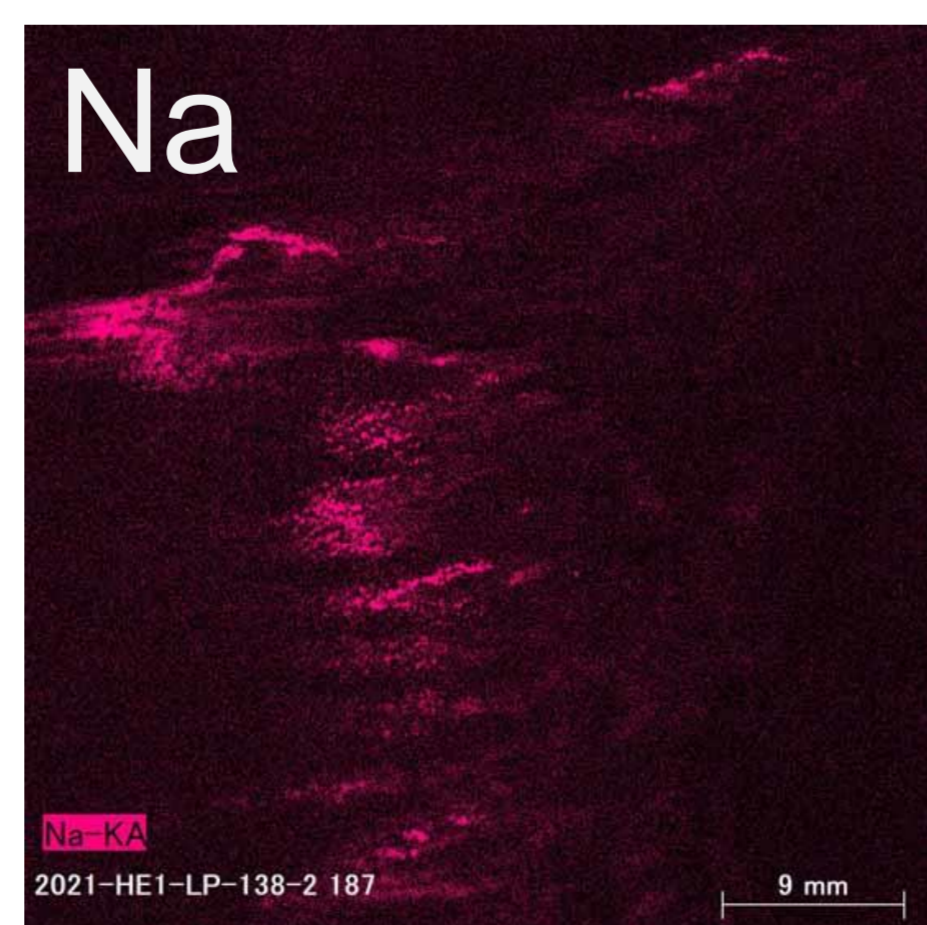
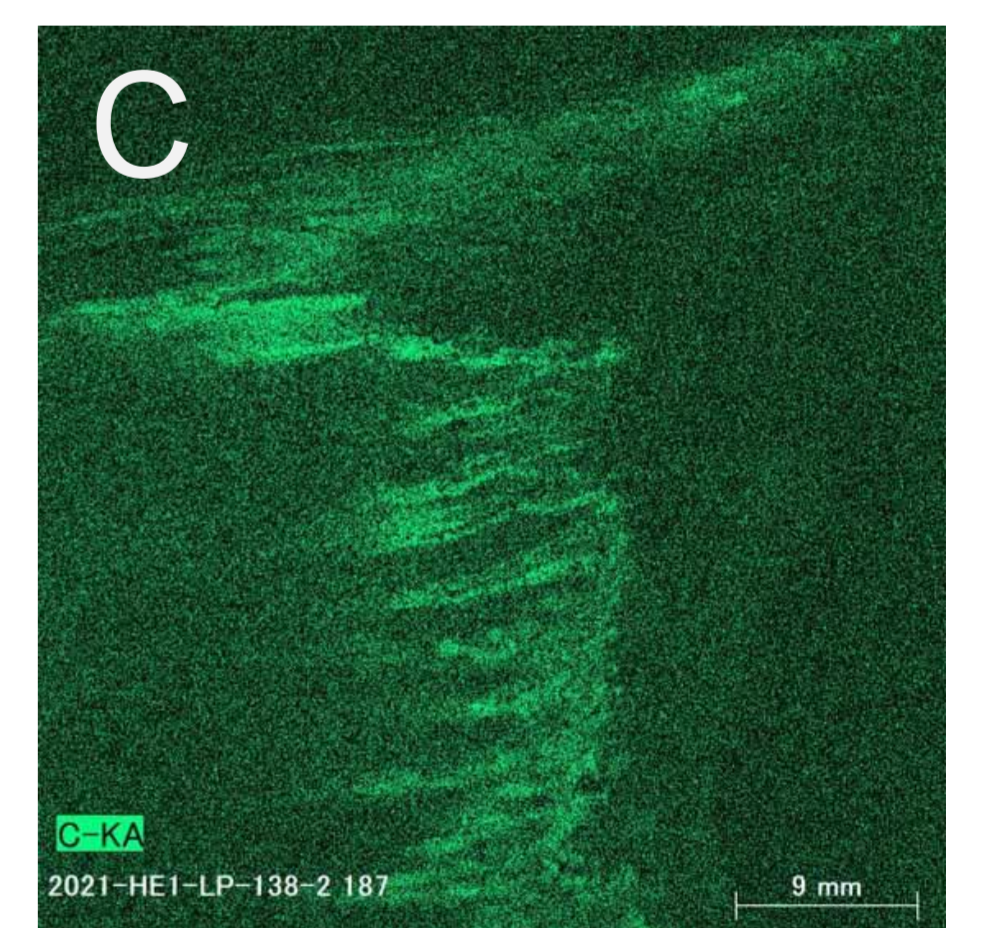
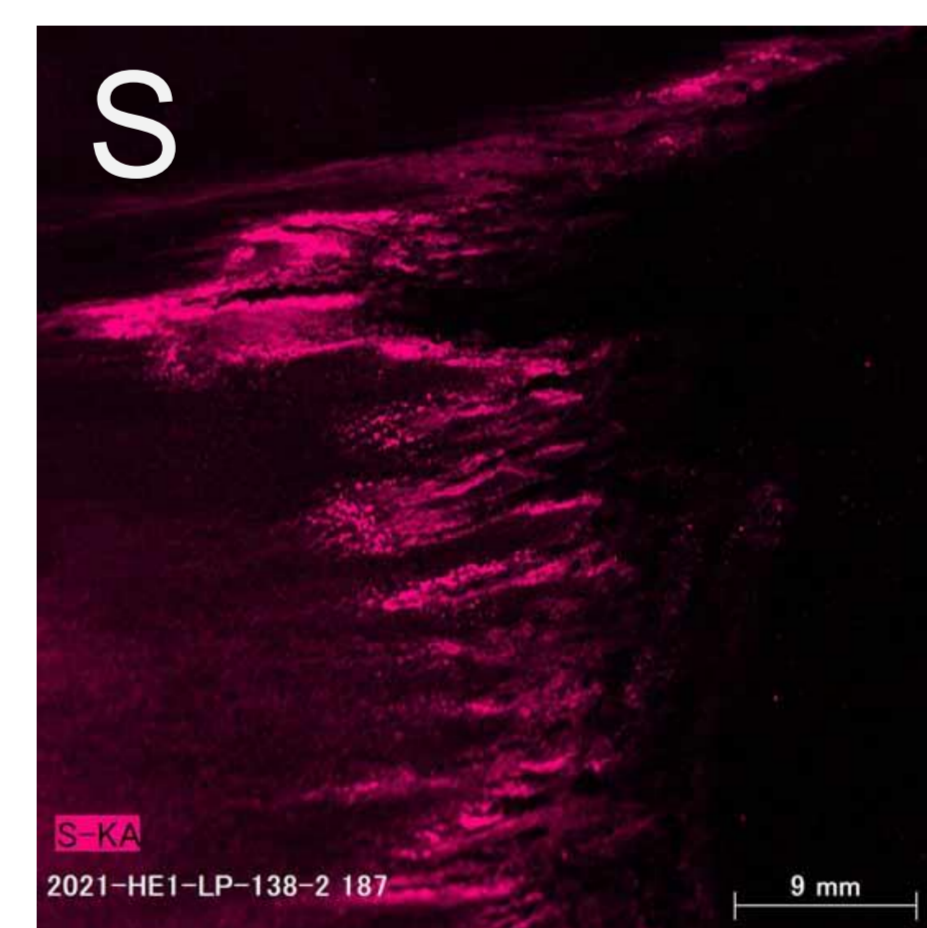
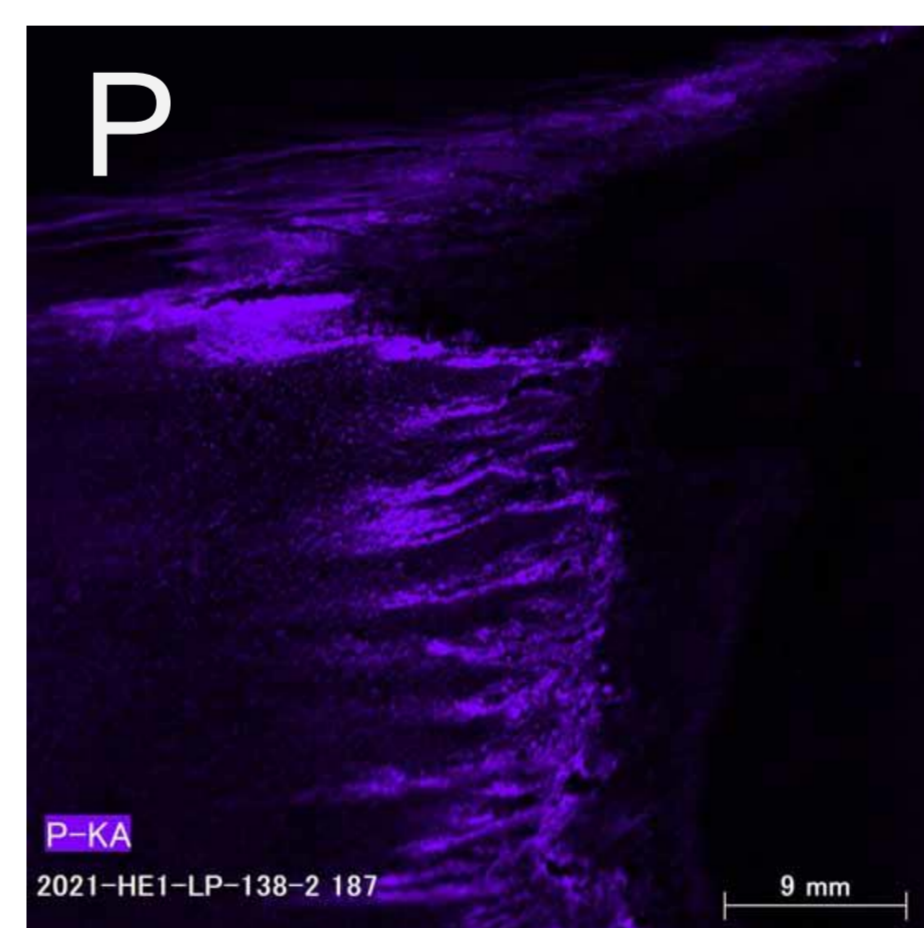
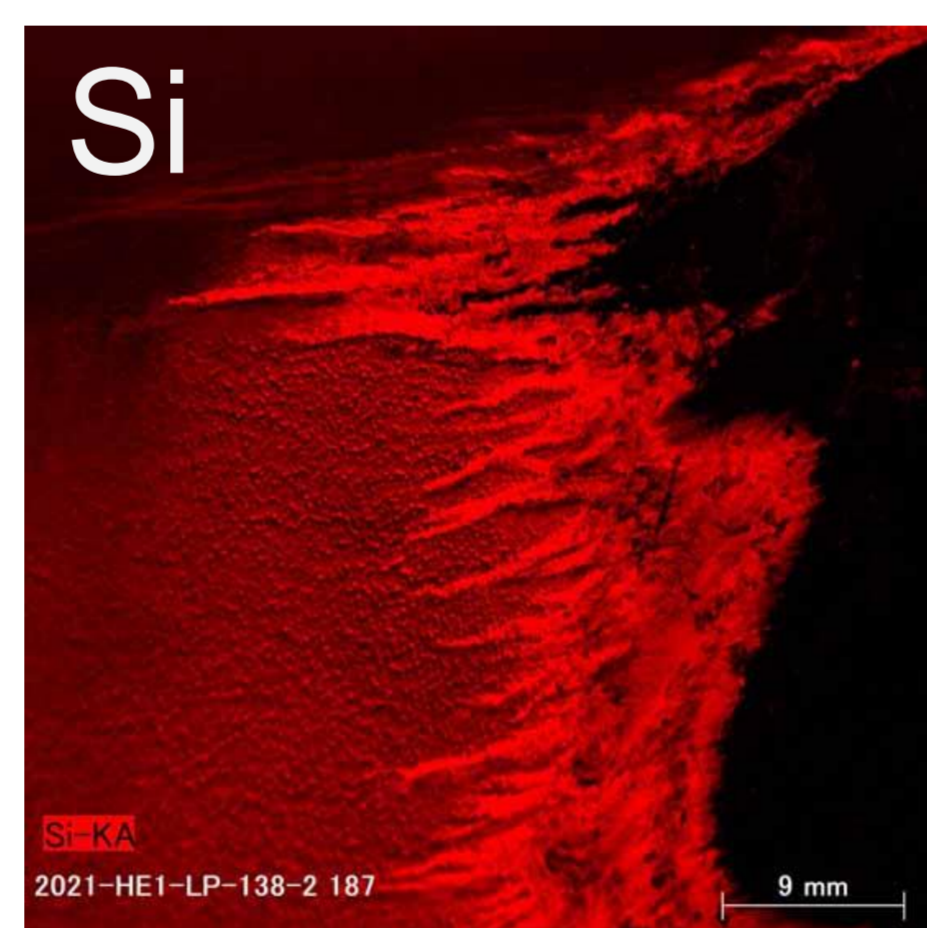
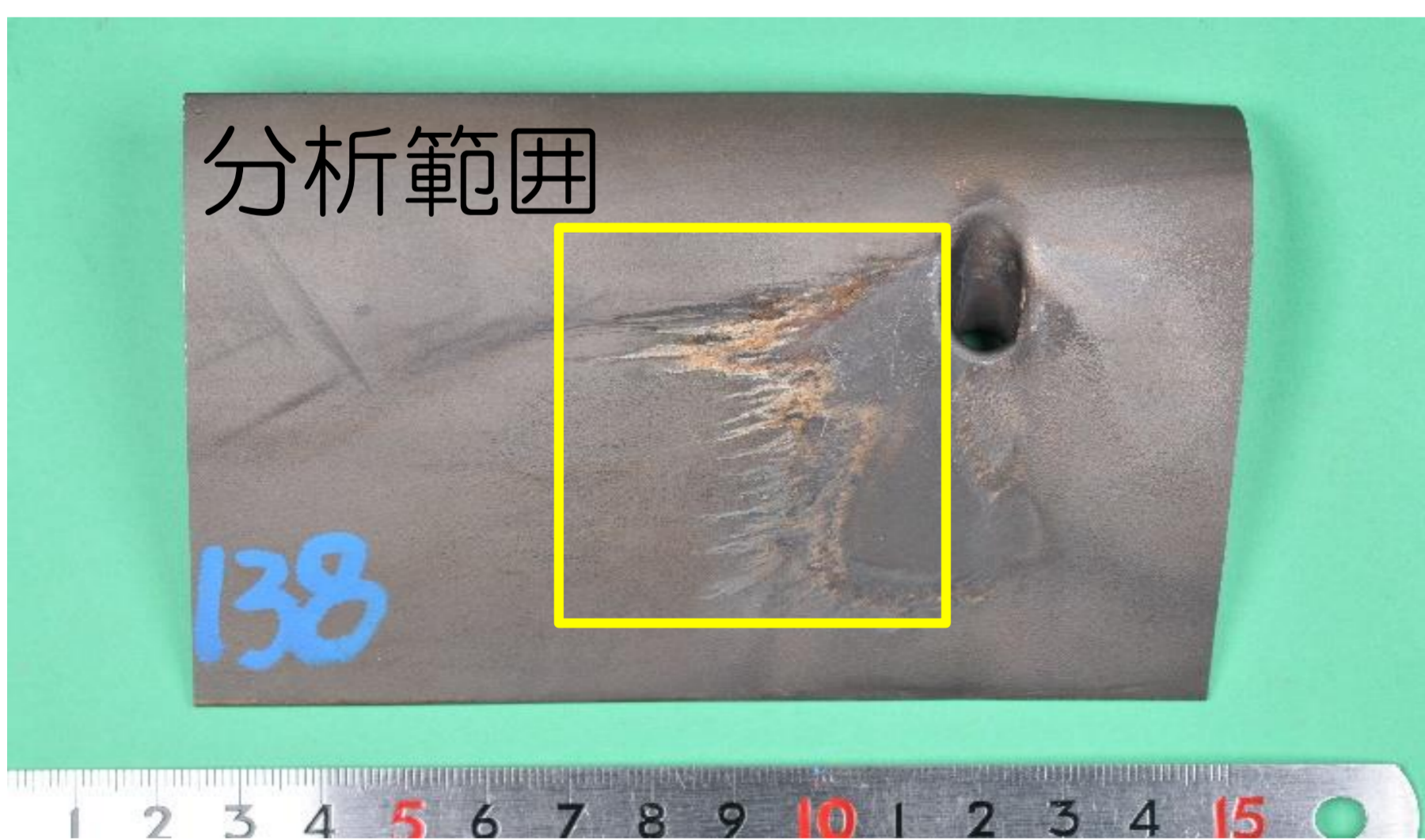
(wt%)

分析箇所	飛来異物に含まれると推定 (除く、ブス端板・碍子)						部材を構成する材料に含まれていると推定												
	Al	Si	S	Cl	K	Ca	Ti	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Zr	Mo	Sn	Pb	
A ブス端板	33.96	0.42	0.84	0.13	<LOD	0.14	0.04	0.04	<LOD	0.60	0.05	<LOD	<LOD	63.65	<LOD	<LOD	<LOD	0.04	1.26
③上金具	0.74	1.28	3.73	1.05	0.10	0.20	0.05	0.02	<LOD	0.82	<LOD	<LOD	<LOD	85.58	<LOD	<LOD	0.04	1.26	
	1.15	1.68	3.95	1.12	0.08	0.21	0.05	<LOD	0.80	<LOD	<LOD	0.05	89.35	<LOD	<LOD	0.05	1.27		
	1.09	1.61	3.49	1.02	0.13	0.67	0.07	0.02	<LOD	0.78	<LOD	<LOD	<LOD	89.52	<LOD	<LOD	0.04	1.35	
⑨スプリング	<LOD	0.81	1.20	0.07	0.27	1.51	0.22	8.57	1.40	47.01	0.42	4.97	0.24	0.35	<LOD	0.13	<LOD	0.26	
	1.37	2.62	4.33	0.15	0.24	1.85	0.29	13.67	1.31	57.06	0.48	6.30	0.22	0.29	<LOD	0.12	<LOD	0.20	
	2.60	4.36	6.10	0.29	0.30	2.25	0.32	20.69	1.17	54.92	0.44	5.28	0.22	0.30	<LOD	0.12	0.02	0.20	
⑩座金	<LOD	0.71	0.70	<LOD	<LOD	0.18	<LOD	14.53	1.01	56.42	0.28	5.82	0.22	0.19	<LOD	0.14	<LOD	0.03	
①碍子表面	4.49	28.60	<LOD	<LOD	2.47	0.39	0.18	<LOD	<LOD	0.70	<LOD	<LOD	0.04	1.93	6.47	0.04	<LOD	<LOD	
B 塗装板	1.65	1.25	2.15	13.45	0.08	4.03	18.02	<LOD	0.11	29.72	0.67	<LOD	0.03	0.18	<LOD	0.00	<LOD	2.40	
	1.72	1.12	5.21	11.74	0.09	4.77	17.03	0.03	0.07	30.02	0.63	<LOD	0.07	0.16	<LOD	<LOD	<LOD	2.30	
	2.02	1.83	6.40	8.99	0.16	5.73	15.75	0.03	0.07	30.08	0.62	<LOD	0.05	0.17	<LOD	<LOD	<LOD	2.10	

ハンドヘルド  
携帯型蛍光X線分析装置



付着異物の調査



マイクロ蛍光X線分析装置

